



應用:

- 1.晶圓鍵合
- 2.加熱狀態下晶圓通電耐久性測試

優點:

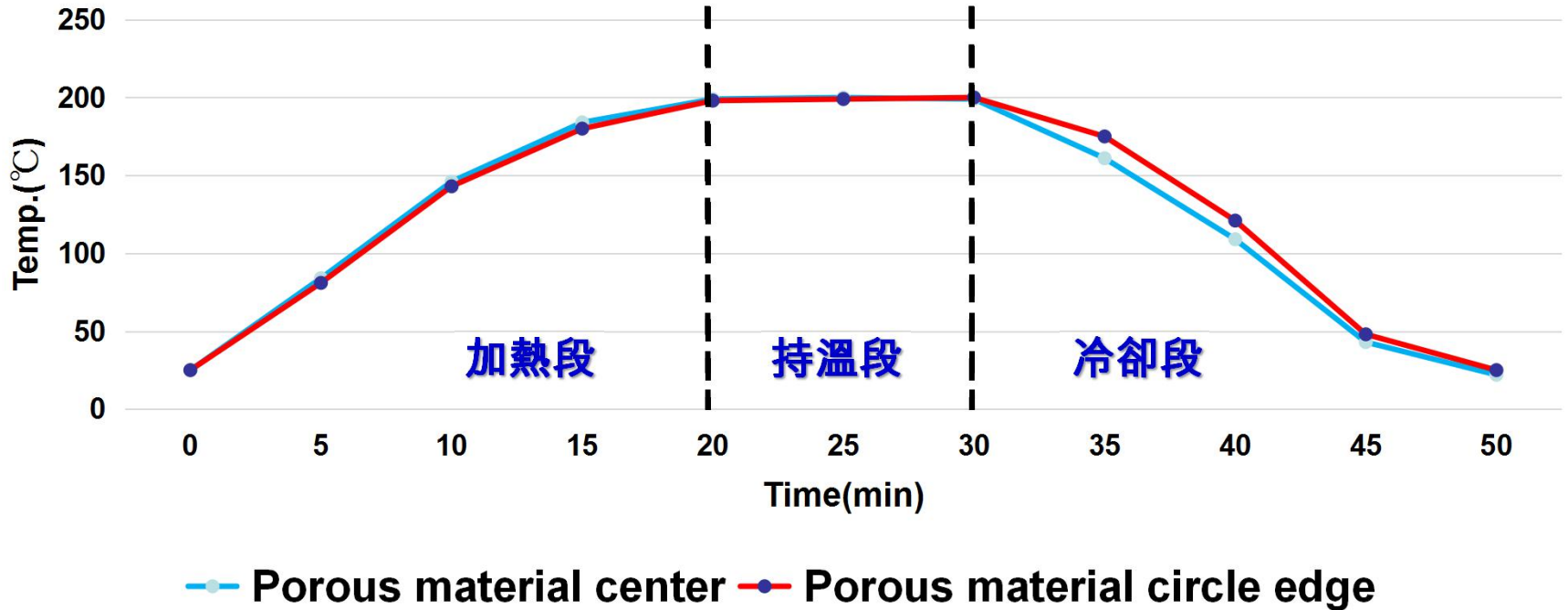
- 1.三區溫控設計，溫度均勻性提升
- 2.升溫冷卻一體式設計，實現高產能
- 3.多孔性陶瓷，平穩吸附
- 4.平面度加工精度高，可達5um (未加熱前)

規格:

多孔陶瓷材質	SiC
孔徑	15-40um
尺寸	φ150 - φ 300 (6 "-12 ")
溫度設定範圍	可達200°C
溫度均勻性	±2 °C(依規格而定)
表面阻抗值	10 ⁶ ~ 10 ⁹ Ω

升溫/冷卻溫度圖

Heating / Cooling process



1. 加熱段: 20分鐘可達最高設定溫度200°C，中心及外圍溫差小
2. 持溫段: 可維持設定溫度，進行製程(如鍵合)
3. 冷卻段: 以水冷方式進行冷卻，實現高產能